



股票代號  
6525



捷敏股份有限公司  
GEM Services, Inc.

法人說明會  
2020/04/10



# 免責聲明

本次法說會所提供之簡報內容包括對於未來狀況之預測與評估之陳述，乃基於公司目前可得資料之概略說明，其涉及風險及不確定性，並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形，提醒各位不要依賴這些資訊，另除非法律要求本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。

# 簡報內容

- 公司概况
- 營運概況
- 財務概況
- 未來展望
- Q&A

# 公司概況

## 創立

- 成立於1998年, 2000年開始量產

## 產能

- 50億顆年封測產能

## 特別技術

- Multi-chip Module (多晶粒模組)
- J-lead Wide Body (內彎腳型封裝)
- Leadless (底部貼焊型)
- Bond-wireless(非鉚線結構):  
Flip chip, Cu Clipper

## 終端應用

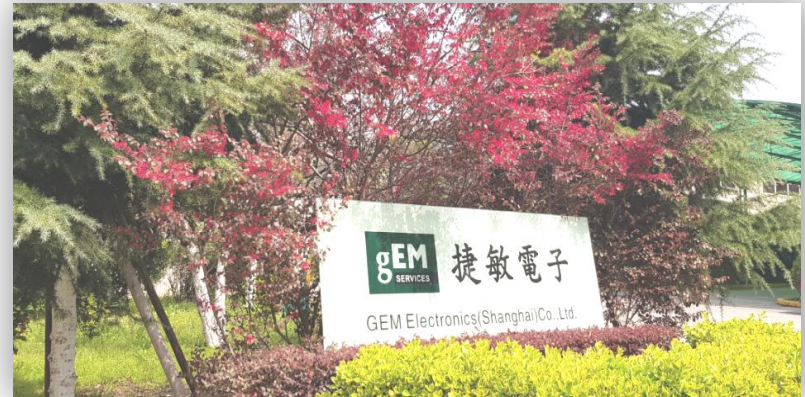
- 電腦, 手機, 手持電子產品
- LCD / 電漿顯示器
- 家電產品

## 員工

- 員工人數: 1,750+ (技術人員: 504+)

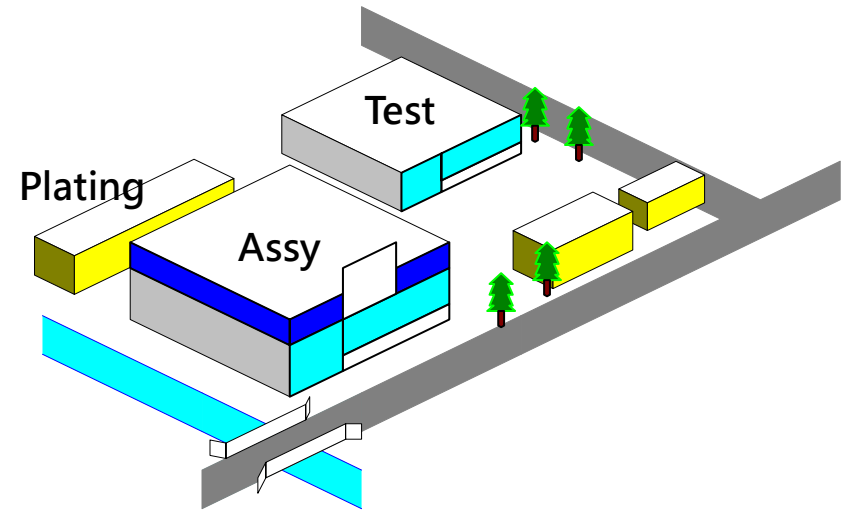
## 營運據點

- 總部: 台灣新北市中和區



- 工業電子系統
- 風力/太陽能電力系統
- 電動車/車載電子

- 上海廠: 中國上海市嘉定區
- 合肥廠: 中國安徽省合肥市



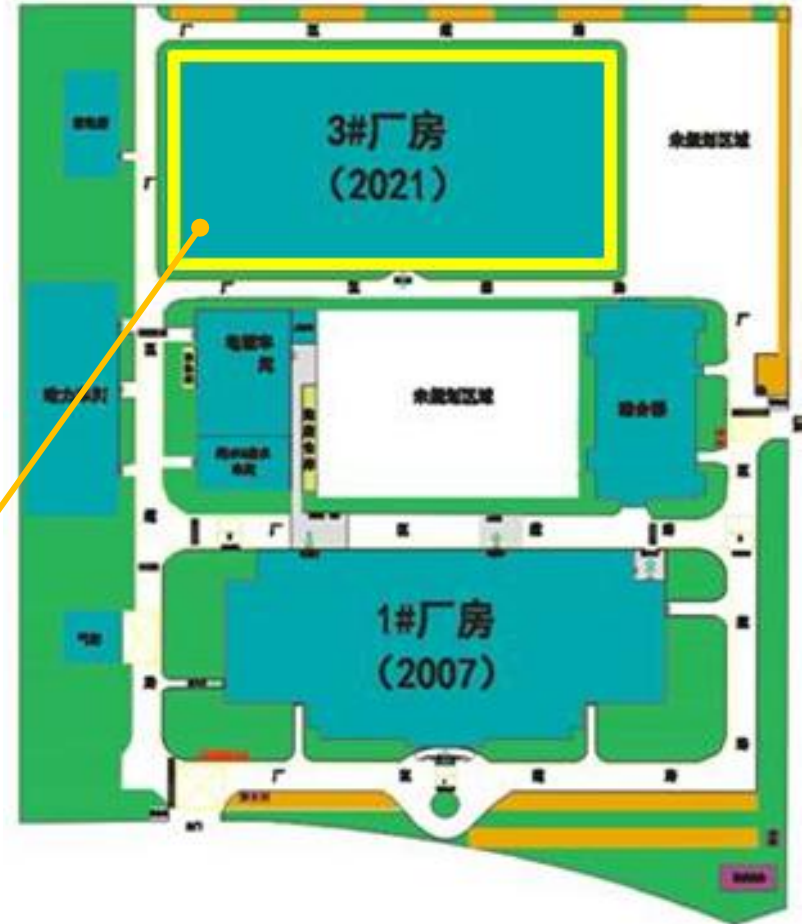
- 土地面積: 19,000 平方公尺 (租賃)
- 建築佔地面積: 15,400 平方公尺
- 樓地板面積: 17,836 平方公尺



- 土地面積: 69,812平方公尺 (自有)  
 建築佔地面積: 17,920平方公尺  
 樓地板面積: 28,588平方公尺
- 合肥新廠房(Bd#3)增建中  
 建築佔地面積: +10,368平方公尺  
 樓地板面積: +35,104平方公尺



## 厂区布局图



## 主要產品及應用

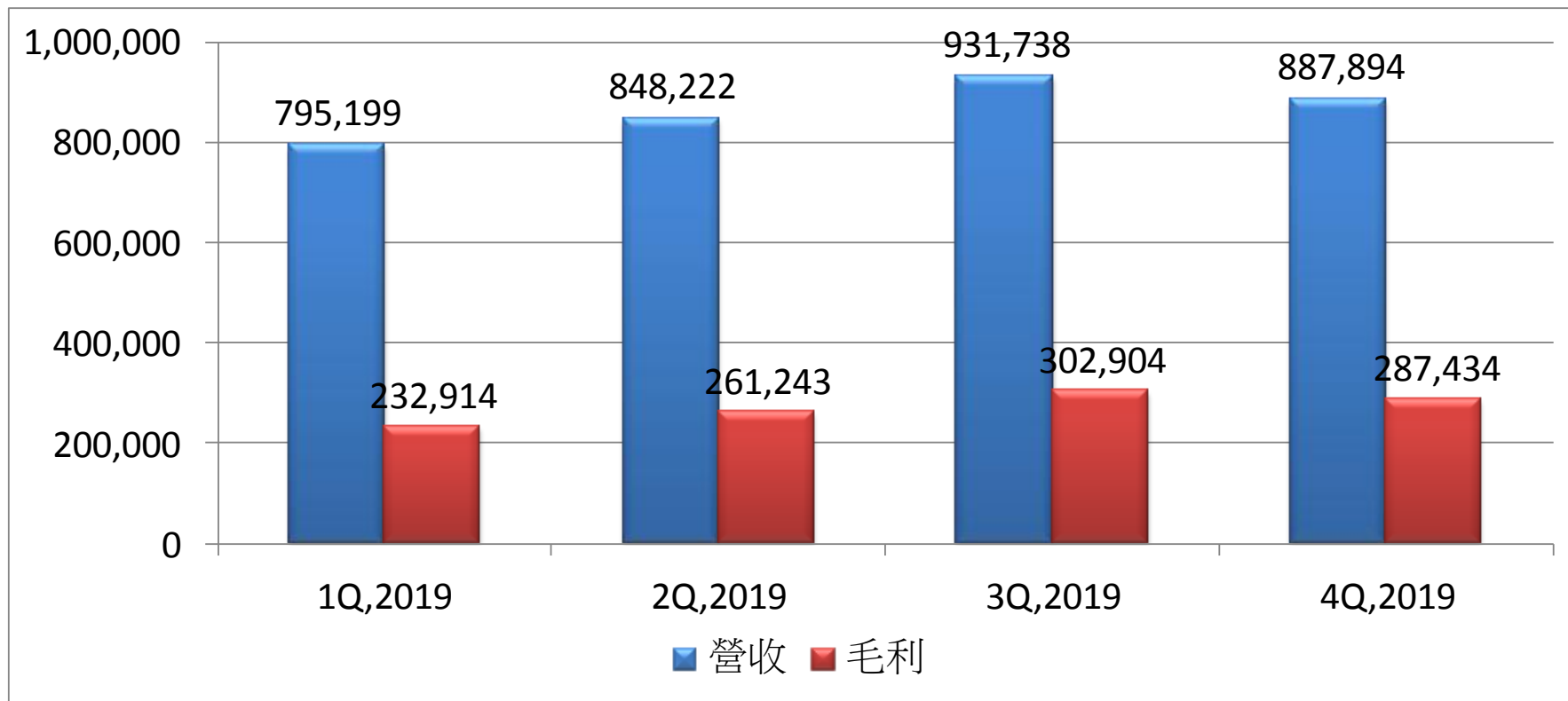
- 提供 高低壓功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、絕緣柵雙級型電晶體(IGBT)、二極體(Diode)及電源轉換或電源管理 IC (Power Management ICs)、功率模組等之封裝與測試服務
- 主要應用於 通訊、電腦/筆電主機板及周邊產品、家電消費性電子產品, 以及任何需要電力系統供其運轉之車用電子及工業用設備機具應用等



# 營運概況

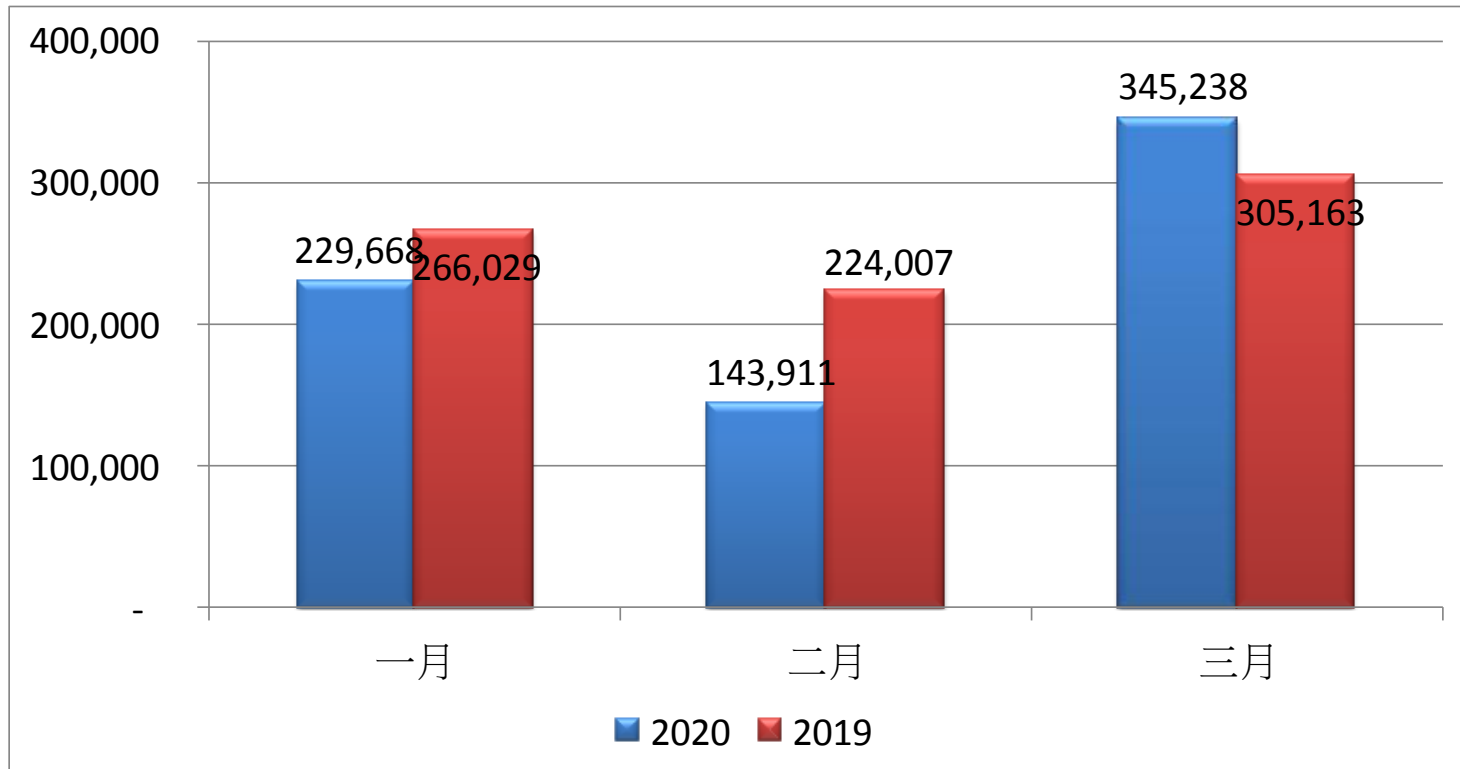
# 2019各季合併營收與毛利

新台幣：仟元



# 2020年各月份合併營收

新台幣：仟元



# 合併損益表

單位：新台幣仟元

	2018年	2019年				
	合計	第1季	第2季	第3季	第4季	合計
營業收入	3,412,024	795,199	848,222	931,738	887,894	3,463,053
營業毛利	1,043,408	232,914	261,243	302,904	287,434	1,084,495
毛利率	30.6%	29.3%	30.8%	32.5%	32.4%	31.3%
營業費用	286,669	73,873	64,561	80,221	70,894	289,549
營業淨利	756,739	159,041	196,682	222,683	216,540	794,946
營業淨利率	22.2%	20.0%	23.2%	23.9%	24.4%	23.0%
營業外損益	200,495	7,343	38,784	29,182	(31,294)	44,015
稅前淨利	957,234	166,384	235,466	251,865	185,246	838,961
所得稅費用	182,871	36,622	53,080	52,585	31,688	173,975
本期淨利	774,363	129,762	182,386	199,280	153,558	664,986
EPS	6.00	1.01	1.41	1.54	1.19	5.15

# 合併資產負債表

單位：新台幣仟元

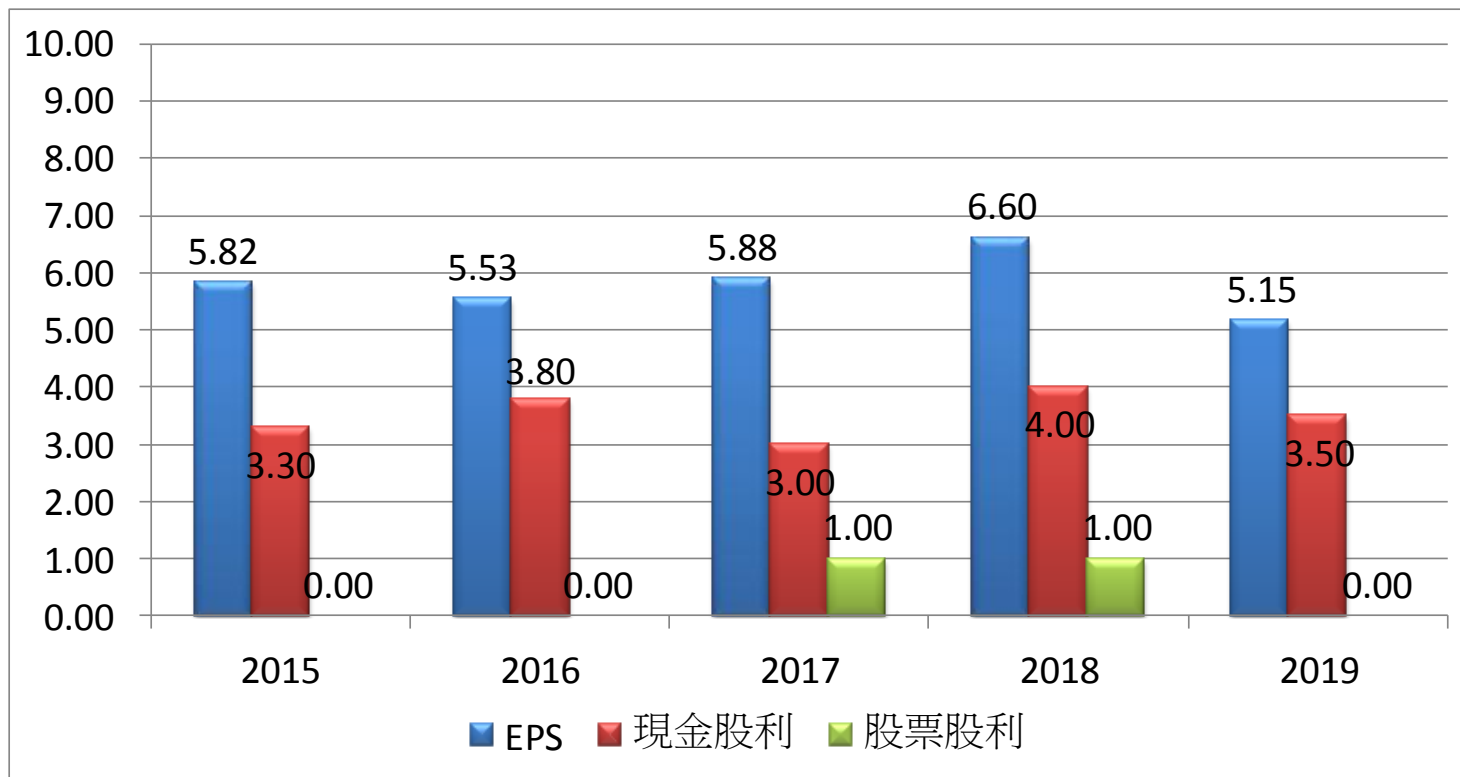
	2018年	2019年			
	第4季	第1季	第2季	第3季	第4季
現金及約當現金	1,863,607	1,996,698	2,106,812	1,875,093	2,011,897
應收款項	714,240	633,859	680,107	741,420	633,131
存貨	94,709	98,197	86,092	111,536	96,106
流動資產合計	2,979,066	3,052,412	3,183,463	3,027,521	3,011,890
不動產廠房設備	1,228,169	1,262,664	1,370,601	1,380,377	1,353,778
非流動資產合計	1,675,524	1,793,677	1,769,811	1,704,832	1,697,881
資產總計	4,654,590	4,846,089	4,953,274	4,732,353	4,709,771
應付帳款	507,378	481,576	454,239	596,467	501,453
流動負債合計	1,140,052	1,112,631	1,539,398	1,173,839	1,058,893
非流動負債合計	14,194	64,396	57,267	52,438	38,420
負債總計	1,154,246	1,177,027	1,596,665	1,226,277	1,097,313
普通股股本	1,173,158	1,173,158	1,173,158	1,290,474	1,290,474
待分配股票股利	-	-	117,316	-	-
資本公積	624,536	624,536	624,536	624,536	624,536
保留盈餘	1,828,600	1,958,362	1,554,169	1,753,449	1,907,007
其他權益	(125,950)	(86,994)	(112,570)	(162,383)	(209,559)
權益總計	3,500,344	3,669,062	3,356,609	3,506,076	3,612,458
負債比率	24.80%	24.29%	32.23%	25.91%	23.30%
流動比率	261.31%	274.34%	206.80%	257.92%	284.44%
本公司每股淨值(元)	29.84	31.28	26.01	27.17	27.99

# 合併現金流量表

單位：新台幣仟元

	2018年	2019年			
	合計	第1季	前2季	前3季	全年
營業活動淨現金流入(出)	955,937	235,970	418,308	761,918	1,036,258
投資活動淨現金流入(出)	(566,592)	(113,573)	(185,688)	(258,558)	(322,796)
籌資活動淨現金流入(出)	(321,442)	(6,757)	(13,031)	(488,525)	(495,144)
匯率變動影響	39,431	17,451	23,616	(3,349)	(70,028)
現金及約當現金淨增(減)	107,334	133,091	243,205	11,486	148,290
期初現金及約當現金餘額	1,756,273	1,863,607	1,863,607	1,863,607	1,863,607
期末現金及約當現金餘額	1,863,607	1,996,698	2,106,812	1,875,093	2,011,897

單位：新台幣元



- 擴增合肥廠產能，目前專注高電壓產品開發與生產為主。新廠建設完成後，產品業務發展方向將做計劃性之擴充。
- 持續高附加價值，以及新半導體材料相關產品之開發。
- 5G、工業用及車用產品市場仍是未來發展的重點。

# Q&A

# 謝謝

